

会社概要 (平成18年3月31日現在)

商号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設立年月日	昭和28年3月20日
資本金	4,753,438,500円
代表者	代表取締役社長 越山 彰
従業員	382名(連結 520名)

株主メモ (平成18年3月31日現在)

決算期	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告 (http://www.fujimiinc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	東京都中央区日本橋茅場町1-2-4 日本証券代行株式会社 本店および各支店
同事務取扱場所	名古屋市中区栄3-3-17 名古屋証券会館5階 日本証券代行株式会社 名古屋支店
同取次所	日本証券代行株式会社 本店および各支店

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画室企画課
TEL：052-503-8181(代表)
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>



FUJIMI TODAY Vol.22

株式会社フジミインコーポレーテッド
株主通信 平成18年6月(第54期事業報告)

→P5~8 特集

もっと強いフジミを目指して。
2010年3月期を最終年度とする
「中期経営計画」を策定しました。

FUJIMI

証券コード 5384

株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。ここに当社第54期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の事業報告をさせていただきます。

当社を取り巻く経営環境

この1年、国内経済は企業収益の大幅な改善に伴う設備投資や個人消費に支えられ堅調に推移しました。高速ネットワークのインフラの整備、インターネット普及率の上昇とともに、パソコンや高機能携帯電話、携帯用音楽機器、薄型テレビなどのデジタル家電製品の販売が拡大し、当社が主力分野とする半導体市場も着実に拡大しました。

このような環境下、当社の主力製品であるシリコンウェハー用ラッピング材およびポリシング材、ハードディスク基板の平坦化に使われるポリシング材、半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるCMP(化学的機械的平坦化)向け製品などがいずれも前年実績を上回り、連結売上高は過去最高を達成しました。

中期経営計画の実現に向けて

当社は、今年3月に中期経営計画を策定し、2010年(平成22年)3月期を最終年度として、連結売上高500億円、営業利益85億円の達成に向けてスタートしました。

中期経営計画では企業ビジョンとして

「超平坦加工のソリューションカンパニー」を掲げ、常にお客様の視点に立って提案する企業を目指すことを確認しています。これらの定量目標と定性目標は、各事業部門に落とし込まれて事業ごとのビジョンと戦略が明示され、業績評価指標により、成果の進捗管理が行われることになっています。設備投資・開発費用の増加や人員確保などの新たな課題も登場していますが、積極果敢に挑戦してまいります。なお、中期経営計画については、今号の特集でもお伝えしています。

経営の透明性をさらに拡大

当社は、平成7年4月のジャスダック証券取引所上場以来、株主・投資家の皆様に向けたIRを重視し、「信頼のフジミ」を心がけてきました。今日、企業の評価は業績のみにとどまらず、社会の一員として法令や倫理綱領を遵守し、企業の社会的責任(CSR)を自覚し行動しているかが問われています。当社では、会社法の施行を受け、内部管理体制の一層の充実を図るため、①リスク管理、②人事管理、③記録管理、④リレーションシップ管理の4つからなるマネジメント体制を強化してまいります。株主の皆様には、今後ともご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

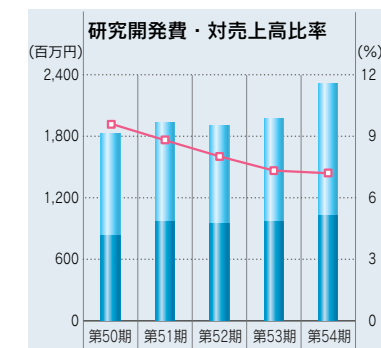
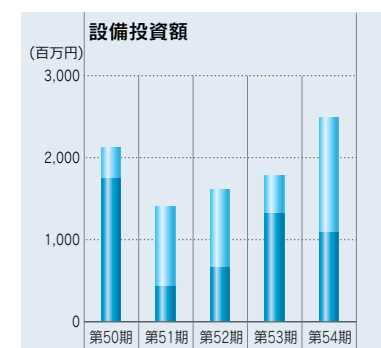
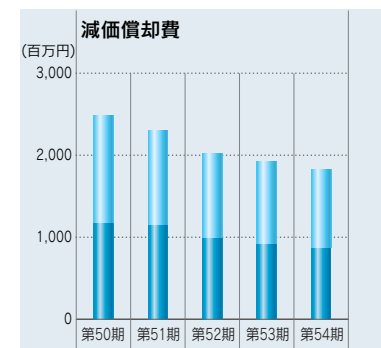
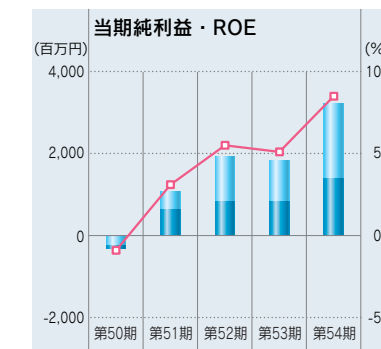
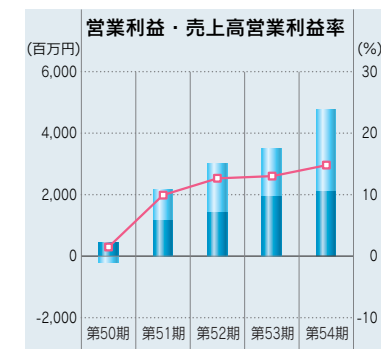
平成18年6月

代表取締役社長 **越山 彰**

Akira Koshiyama



連結決算ハイライト



全社を挙げて積極的な営業活動を展開するとともに、生産活動においてもフル稼働で対応した結果、当社の連結売上高は321.2億円となり、前期比18.5%増を達成しました。営業利益につきましては、一部の原料価格の高騰はあったものの、生産性の向上により原価低減を図り、販売管理費の削減に努めた結果、前期比35.8%増の47.7億円となりました。売上高営業利益率は14.8%と改善しました。

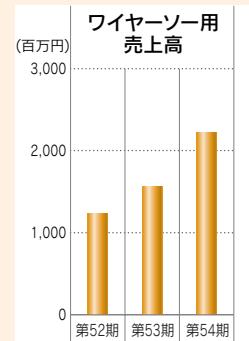
当期純利益は、前年同期比75.9%増の32.0億円となり、

その結果、ROEは8.5%となりました。この大幅な増加要因は、売上の増加によるものと、前年に減損会計の早期適用による特別損失を4.1億円計上したことによります。

設備投資につきましては、本社、各務原を中心に工場増産設備7.3億円、研究開発センターの評価・測定装置に7.3億円、米国子会社の増産設備等に2.7億円など、総額24.8億円の投資を行いました。

フジミの事業とセグメント情報

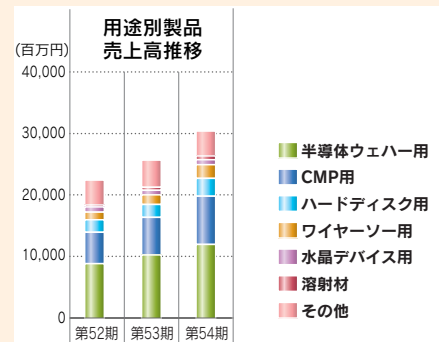
シリコン切断に使用されるワイヤーソー用砥粒は、特に半導体ウェハー向けの出荷が拡大し、全体の売上高は22.2億円(前期比42.1%増)と好調でした。水晶デバイス用研磨材は、小型化・薄型化による消耗材の使用量減や単価下落の影響があったものの、高機能携帯電話への買替需要や自動車の電装化の進展により市場が拡大したため、売上高は、8.0億円(前期比9.3%増)となりました。サーメット溶射材は堅調に推移し売上高は6.1億円(前期比26.6%増)と大幅に増加しました。



ワイヤーソー用、水晶デバイス用、溶射材、その他の用途



水晶デバイスは周波数制御・選択用電子部品として周波数の安定度、秩序および通信の質を守るために情報端末機器、携帯電話端末、デジタルカメラ、コードレスホンなどの、日常に密着した機器に幅広く使用されている。最近では自動車の車速感知などの制御系にも利用される。



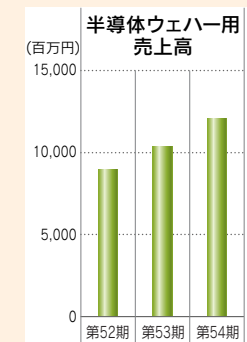
※グラフは商品を含めない自社製品のみでの売上高です。

半導体ウェハー用

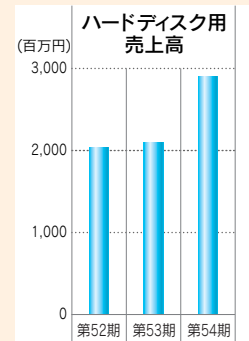


シリコンウェハーに代表される半導体基板は300mmウェハーへの移行に伴い、両面研磨など、より高精度な鏡面研磨が要求されてきている。

パソコンを中心に、OA機器やAV製品など、電子・IT関連機器類の心臓部に使用されている半導体素子。この半導体素子を製造するには、シリコンウェハーに代表される半導体基板を高精度に鏡面研磨しなければなりません。半導体市場全体は、パソコンの出荷拡大、携帯電話端末の高機能化による買替需要の増加、携帯音楽端末などの普及により順調に拡大しました。主力製品「FO」などラッピング材は一部リサイクルや研削の動きの影響を受け1.4%増にとどまりましたが、ポリシング材「GLANZOX」は300mmウェハーの拡大により25.5%増と大幅に売上を伸ばし、半導体ウェハー向け製品全体では、売上高120.8億円(前期比16.4%増)となりました。



パソコンの高機能化に伴い、プログラムやデータの高速読み出しが可能な小型・大容量メモリーのハードディスクが注目を集めています。このような環境下、ディスクの表面研磨についても、シリコンウェハーと同等以上の面精度が要求されるようになりました。フジミはこの分野でも高い評価と信頼を得ています。パソコン向けのディスク市場は、インターネットのインフラ整備が進む中、高性能パソコン

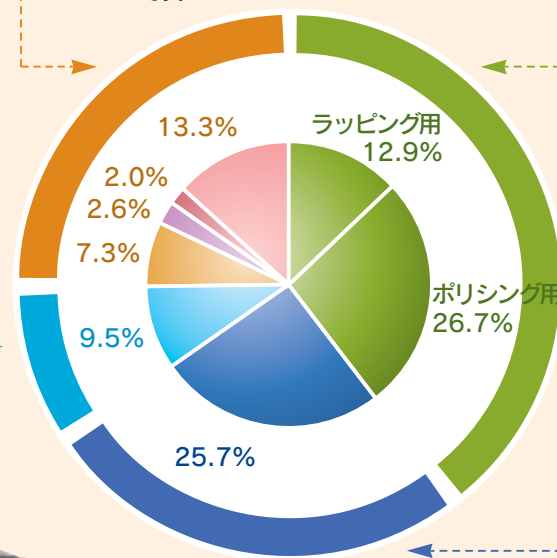


の低価格での市場投入がなされ、買替需要が増加しました。また、HDD搭載型DVDレコーダーや小口径HDD内蔵型携帯音楽機器等のデジタル家電の拡大によりハードディスクの需要は堅調に推移し、当社のディスク向け製品も売上高28.9億円(前期比38.2%増)と大幅な改善を示しました。

ハードディスク用



ハードディスクドライブは磁性体を塗布したアルミニウムやガラスのディスクを一定の間隔で何枚も重ねた構造の記憶装置で、モーターで高速に回転させ磁気ヘッドを近づけてデータを読み書きする。パソコンをはじめとするほとんどのコンピュータに搭載されており最近ではデジタル家電への搭載が進んでいる。ディスクの大きさは、ノートパソコン向けは2.5インチ、デスクトップパソコン向けは3.5インチがそれぞれ主流。

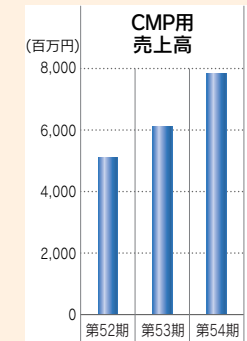


CMP用



情報通信機器やエレクトロニクス製品向けデバイスウェハーの多層配線化要求が高まったことから、中央集積回路やメモリなどの記憶素子を中心とした多くのデバイスにCMP(化学的機械的平坦化)プロセスが導入されている。

長年にわたるシリコンウェハー向けファイナルポリシング材のノウハウを応用して開発されたCMP向け製品は、現在市場からも高い評価を得ています。エレクトロニクス製品の小型化とともに高機能化・高性能化が急速に進み、半導体デバイスのさらなる高集積化・多層配線化が要求される中、今後も引き続き高成長が期待される分野です。その優れた品質特性から「PLANERLITE」シリーズを中心にユーザーの採用が拡大し、売上高は78.4億円(前期比28.4%増)と順調な伸びを示しました。



特集

もっと強いフジミを目指して。 2010年3月期を最終年度とする 「中期経営計画」を策定しました。

当社は、1年前に各事業別の事業ビジョン・戦略目標を検討する中から業績評価指標や数値目標を設定し、アクションプランにまで具体化した経営改革の手法「バランス・スコアカード(BSC)」を導入しました。その後、さらにこのBSCの考え方を活用して「中期経営計画」を取りまとめ、フジミグループ全体の目標として取り組むこととなりました。今号では、その概要について、株主の皆様にお知らせいたします。

フジミグループの「中期経営計画」

「中期計画」が掲げる数値目標についてお聞かせください。

数値目標は、次の2つの目標からなります。到達点は4年後の2010年(平成22年)3月期です。

■ 2010年3月期の企業ビジョン(定量目標)

	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	321.2億円	500億円 (+55%)
営業利益	47.7億円	85億円 (+78%)

これは、当期の実績と2010年3月期を比較したものです。4年後の目標として、より高いターゲットを設定し、チャレンジしていきます。

「中期計画」には数値以外の目標もありますか。

「中期計画」はフジミのあるべき姿を追求したものです。数値以外に定性目標を掲げました。

■ 2010年3月期の企業ビジョン(定性目標)

超平坦加工のソリューションカンパニー (常にお客様の視点に立って提案する企業)

フジミは何を作っている会社かよく分からない——株主様からのアンケートにしばしば寄せられるご意見です。私たちの製品は、半導体ウェハの研磨や半導体チップ上の多層配線の平坦化に用いられるため、一般にはほとんど目にすることがありません。そのため、事業の内容が正しく伝わらないもどかしさを常に感じてきました。これからは先端技術に必要な“平坦加工”のことならなんでもフジミにお任せください、といえる企業を目指します。もちろん、

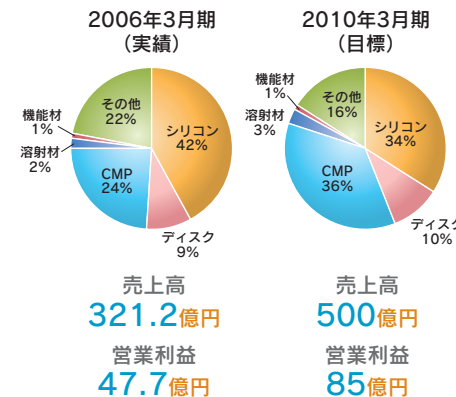
お客様の視点を第一に、斬新なソリューションをどんどん提案してまいります。

事業部門別の戦略

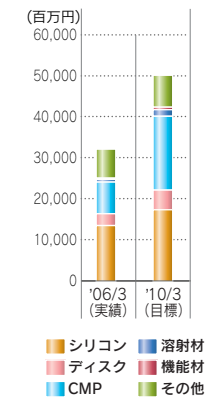
「中期計画」によって事業部門別の売上構成はどのように変化しますか。

これからの4年間で半導体製造プロセスの微細化が進み、電子部品の高機能化が一段と進むものと思われ、当社の売上構成もそれに伴って変化します。下の図は、現状と4年後の売上構成を比較したものです。具体的な内容は、各事業の取り組みをご覧ください。

■ 事業別売上高構成比



■ 事業別売上高



シリコン事業: 半導体装置の基板となるシリコンウェハの切断や研磨などに使用される研磨材製造販売。

ディスク事業: パソコンやカーナビなどに搭載されている記憶装置(ハードディスク)の研磨に使用される研磨材の製造販売。

CMP事業: Chemical Mechanical Planarizationの略。配線の構造上、多層配線(垂直方向に配線を複数積み重ねた、立体的な配線構造)をつくる技術において、電子回路の表面を化学的・機械的に平坦化する技術。これらに用いられる研磨材(CMPスラリー)の製造販売。

機能材事業: 小口径、曲率の深い光学レンズなどの加工に適した精密研削砥石の製造販売。

溶射材事業: 溶射とは、熱や磨耗、腐食などに対する強度を高めるために、素材の表面を金属やセラミックスを溶かしながらコーティングすること。その材料となる溶射材の製造販売。

各事業部門の目標と重点の取り組みについてお聞かせください。

各事業部門の目標を簡単にまとめました。

シリコン事業

	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	136億円	172億円

半導体の基板であるシリコンウェハを高精度に平坦化・鏡面研磨する研磨材です。顧客へのタイムリーな新製品の供給とトータルコストメリットの提言を目指します。また、モノづくりの意識を高めコア技術の確立と発展に注力し、高い世界シェアを維持します。

CMP事業

	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	78億円	180億円
世界シェア	11.7%	20% 達成

半導体チップの高集積化を多層配線で実現するCMPは今後も拡大が期待されます。売上面では、顧客ロードマップに合った迅速な開発品の提供や技術サービスを核に、より密接な顧客との関係構築や開発力の強化を目指します。収益性の面では、安定品質の提供に努め、開発経費効率化や製造原価率の低減を図ります。

ディスク事業

	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	28.9 億円	47.8 億円

パソコンやHDD搭載型DVDレコーダーなどの記憶媒体であるハードディスク用の研磨材です。各業界のニーズをいち早くキャッチし、開発期間の短期化により顧客の要求に合った開発品をタイムリーに提供します。また、生産技術力を高め、低コスト化に向けた製造プロセスの改善を図り、生産コストの削減により利益率の向上につなげます。

溶射材事業

	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	6.1 億円	17 億円

溶射業界向けにサーメット溶射材とセラミックス溶射材を供給しています。開発力を強化し、新規高機能品の早期上市やタイムリーなソリューションの提案により、売上の大幅拡大を目指します。安価原料の確保、収率のアップと生産技術の向上でコストダウンを図っていきます。

機能材事業

	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	2.1 億円	4.8 億円

光学レンズ加工用のダイヤモンドペレットで業界をリードします。開発人員の増員を図り、高能率/低面粗度を実現することにより、圧倒的な高性能品の提供で売上の増大を目指します。また技術・営業情報の共有化と活用を通して提案型営業を実践し、さらには生産技術人員

の増員により、生産性の向上とコストダウン・営業利益の向上を図ります。

その他事業

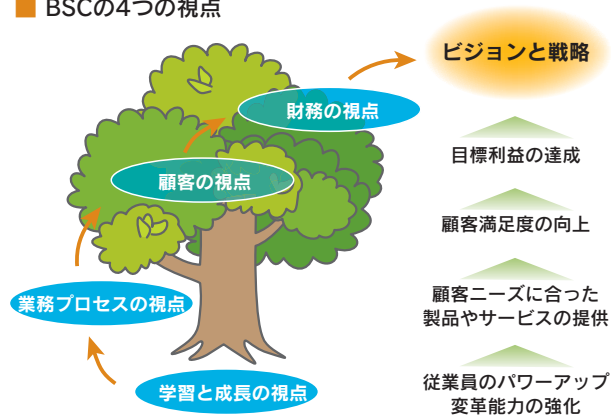
	2006年3月期(実績)	2010年3月期(目標)
売上高	69.1 億円	78.5 億円

既存製品、商品に加え新規事業を含みます。新たな芽を確実な事業に育てます。

Q それぞれの事業部門では、どのような取り組みが行われているのでしょうか。

事業部門ごとに、BSCによる詳細な戦略マップを作成しています。この4年間で、「従業員のパワーアップと変革能力の強化」⇒「業務プロセスの改善/顧客ニーズに合った製品やサービスの提供」⇒「顧客満足度の向上」⇒「目標利益の達成」と一歩一歩着実に目標をクリアしていきます。

■ BSCの4つの視点



■ 株主の皆様へ「中期経営計画」をご理解いただくために



高井経営企画室長に聞く

題に取り組みます。

まず最優先に考えるのは「顧客の視点」です。お客様の満足が得られなければ、「財務の視点」の目標である収益の拡大は見込めないからです。また、顧客満足を達成するには、「業務プロセスの視点」である業務効率の改善や製品開発力の強化が必須となり、これを成し遂げるのは従業員一人ひとりであって、「学習と成長の視点」が企業成長の根幹となると考えます。これらの4つの視点がうまくかみ合うことにより中期経営計画の達成が可能となるのです。

Q 「中期経営計画」はどのような背景から生まれたものですか。

高井 当社は、昨年「バランス・スコアカード」という経営手法を取り入れています。これは「フジミのありたい姿」を明確にし、それを組織の末端まで浸透させ行動に結びつけるものです。将来の挑戦的な目標を達成するには、ある程度時間の経過が必要ですので、4年後の2010年3月期を到達点とする「中期経営計画」となりました。

Q 「中期経営計画」と「バランス・スコアカード」の関係がいまひとつ分かりません。

高井 私たちは中期経営計画を達成するため、BSCの4つの視点から課

く、ROA(総資産利益率)やROE(株主資本当期純利益率)も着実に改善するでしょう。各種の経営指標が改善し企業価値が向上すれば、株式市場にも評価され、株価にもよい影響をもたらすと考えられます。利益拡大に応じた配当政策も積極的に実施したいと思います。

Q 設備投資や人員の確保に変化はありますか。

高井 人の増員と設備の拡充は当然必要となります。まず人員ですが、パートタイマーも含め現在の670人体制から4年後には900人体制に拡大するため、採用・教育に全力をあげます。設備投資は、今号の「News & Topics」でもご紹介しましたように各務東町第三工場(仮称)などに、今年だけで53億円の大きな投資を計画しています。これによって新たな減価償却負担が発生することになります。大きなジャンプの前には誰もが一度しゃがみこんで力を蓄えますが、「中期経営計画」という大きな目標達成のために、今年より先行投資を実施し、製造・開発体制の構築を進めてまいります。

Q 株主にはどのような利点があるのでしょうか。

高井 「中期経営計画」は単なる売上や営業利益の目標にとどまりません。企業価値の向上も意識したものです。当社が開発・製造する製品が順調に売上とシェアを伸ばすということは、当然ながら利益も上がります。その結果、1株当たりの利益だけだ

連結財務諸表

(単位：百万円)

連結損益計算書	第53期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	第54期 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで
売上高	27,109	32,127
売上原価	18,206	21,415
販売費及び一般管理費	5,388	5,939
営業利益	3,514	4,772
営業外収益	133	160
受取利息/配当金	34	59
その他	99	101
営業外費用	33	40
支払利息	30	27
その他	3	12
経常利益	3,614	4,892
特別利益	44	51
特別損失	510	103
税金等調整前当期純利益	3,147	4,840
法人税、住民税及び事業税	1,490	1,577
法人税等調整額	△170	16
少数株主利益	4	39
当期純利益	1,823	3,207

売上高

半導体ウエハー向け製品は、ウエハーの高品質化ニーズからポリシング材製品の出荷が大幅に増え、ラッピング材を含めた全体でも大きく増加しました。多層配線工程向けCMPスラリーは、技術の進展に伴い、市場が拡大した結果、国内外のデバイスメーカーへの出荷が増大し、売上は増加しました。また、ハードディスク向け製品も、製品開発競争や価格競争の激化はあったものの、パソコンの出荷増やデジタル家電に搭載が進むなどハードディスクの需要枚数の増加も追い風となり、増加いたしました。その結果、総売上高は、前期比18.5%増となりました。

(単位：百万円)

連結剰余金計算書	第53期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	第54期 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	5,038	5,040
資本剰余金期末残高	5,040	5,045
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	26,800	28,112
利益剰余金増加高	1,823	3,207
当期純利益	1,823	3,207
利益剰余金減少高	511	862
配当金	471	822
役員賞与	40	40
利益剰余金期末残高	28,112	30,457

営業利益

売上の増加により、一部の原材料の高騰はあったものの、固定費を削減したことにより、売上原価率が0.4ポイント改善しました。販売費及び一般管理費のコスト削減にも努めた結果、営業利益は、前期比35.8%の増加となりました。

当期純利益

前期に減損会計の適用により特別損失を4.1億円計上したため、当期純利益は前期比75.9%増の32.0億円となりました。

連結貸借対照表

	第53期 平成17年3月31日現在	第54期 平成18年3月31日現在
資産の部		
流動資産	25,874	29,341
現金及び預金	12,594	12,058
受取手形及び売掛金	7,839	10,054
たな卸資産	4,262	4,952
その他流動資産	1,202	2,304
貸倒引当金	△25	△28
固定資産	17,573	17,998
有形固定資産	14,268	14,822
無形固定資産	366	295
投資その他の資産	2,939	2,880
資産合計	43,448	47,340

流動資産

受取手形及び売掛金と、その他流動資産のうち有価証券(金銭信託)が大幅に増加し、流動資産は前期末比34.6億円増加しました。

固定資産

当期の設備投資は、本社工場増設及び商品開発の試験設備などにより24.8億円となりました。減価償却費が18.2億円となり、有形固定資産は前期末比5.5億円の増加となりました。

(単位：百万円)

	第53期 平成17年3月31日現在	第54期 平成18年3月31日現在
負債の部		
流動負債	7,051	7,852
支払手形及び買掛金	3,641	4,276
短期借入金	604	354
その他流動負債	2,805	3,221
固定負債	311	187
負債合計	7,362	8,039
少数株主持分	36	84
資本の部		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,040	5,045
利益剰余金	28,112	30,457
その他有価証券評価差額金	93	230
為替換算調整勘定	△199	361
自己株式	△1,751	△1,630
資本合計	36,049	39,217
負債、少数株主持分及び資本合計	43,448	47,340

負債

流動負債は、前期末比8.0億円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるものです。固定負債は、長期未払金の減少により1.2億円の減少となりました。

株主資本

株主資本は、前期末比31.6億円増加し、株主資本比率は、82.8%となりました。

個別決算の概要

(単位：百万円)

連結キャッシュ・フロー計算書	第53期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	第54期 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,584	3,251
税金等調整前当期純利益	3,147	4,840
減価償却費	1,925	1,824
土地減損損失	412	—
売上債権増減額	△850	△2,061
仕入債務増減額	697	489
たな卸資産増減額	△1,101	△248
その他	△75	123
小計	4,155	4,968
利息及び配当金の受取額	34	59
法人税等の支払額	△607	△1,748
その他	1	△27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,851	△2,811
有価証券の取得による支出	—	△1,000
有価証券の売却及び償還による収入	66	—
有形固定資産取得による支出	△1,738	△1,923
投資有価証券の償還による収入	—	517
子会社株式取得による支出	—	△345
その他	△177	△61
財務活動によるキャッシュ・フロー	△518	△1,005
短期借入金の純増加(減少)額	172	△309
自己株式の取得及び売却による収支	△220	126
配当金の支払額	△471	△822
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	192
現金及び現金同等物の増加(減少)額	1,193	△373
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	356	—
現金及び現金同等物期末残高	11,419	12,969
現金及び現金同等物期末残高	12,969	12,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、32.5億円(前期比9.3%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が48.4億円(前期比53.8%増)計上されたものの、売上債権が20.6億円(前期比142.3%増)と増加したことに加え、法人税等の支払額が17.4億円(前期比188.1%増)と大幅に増加したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、28.1億円(前期比51.9%増)となりました。これは主に有価証券(金銭信託)の取得による支出10.0億円および有形固定資産取得による支出19.2億円(10.7%増)によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は10.0億円(前期比93.7%増)となりました。これは主に短期借入金の返済額3.0億円や配当金の支払額8.2億円によるものであります。

現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が48.4億円(前期比53.8%増)となりましたが、売上債権の増加や法人税等支払額の増加、有価証券の取得等により、前連結会計年度末に比べ、3.7億円減少し、当連結会計年度末には125.9億円となりました。

(単位：百万円)

損益計算書	第53期 平成16年4月1日から 平成17年3月31日まで	第54期 平成17年4月1日から 平成18年3月31日まで
売上高	23,422	27,064
売上原価	15,835	18,428
販売費及び一般管理費	4,328	4,835
営業利益	3,258	3,800
営業外収益	229	297
営業外費用	3	11
経常利益	3,484	4,086
特別損益	△466	△52
税引前当期純利益	3,017	4,034
法人税、住民税及び事業税	1,310	1,370
法人税等調整額	△65	23
当期純利益	1,772	2,640
前期繰越利益	2,370	2,564
中間配当額	234	529
当期末処分利益金	3,908	4,675

(単位：百万円)

貸借対照表	第53期 平成17年3月31日現在	第54期 平成18年3月31日現在
資産の部		
流動資産	23,238	25,868
固定資産	18,329	18,741
資産合計	41,568	44,610
負債・資本の部		
流動負債	5,879	6,985
固定負債	292	187
負債合計	6,172	7,172
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,040	5,045
利益剰余金	27,260	29,038
その他有価証券評価差額金	93	230
自己株式	△1,751	△1,630
資本合計	35,396	37,437
負債及び資本合計	41,568	44,610

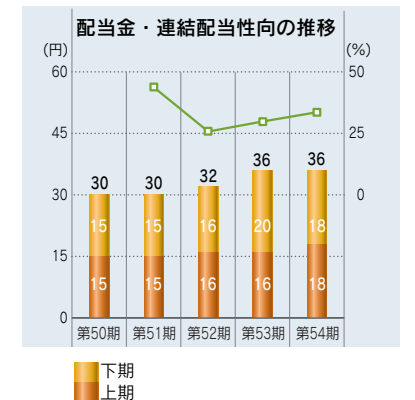
(単位：百万円)

利益処分	第53期	第54期
当期末処分利益金	3,908	4,675
配当金	293	530
役員賞与金	40	50
別途積立金	1,010	1,500
次期繰越利益金	2,564	2,595

(注) 平成17年12月9日に529百万円(1株につき18円00銭)の中間配当を実施しております。

配当金および連結配当性向の推移

当期の配当につきましては、中間配当の18円を含め年間36円となり、連結配当性向は33.5%となりました。当社は一層の株主重視経営に向け、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の最重要課題と位置づけ、業績に応じた積極的な株主還元に取り組んでまいります。具体的には30%以上の連結配当性向を目標として配当を実施いたします。なお、平成17年3月末日を基準日として1：2の株式分割を実施しましたが、1株当たりの配当金を36円に据え置きましたので、実質倍額の配当金となっております。



01 フジマイクロテクノロジーが創業10周年を迎えました

マレーシアの子会社、フジマイクロテクノロジー(略称FMT)が創業10周年を迎えました。昨年12月にベナンで行われた創業記念式典には、現地従業員、当社役員のほか、これまでご支援いただいた多数のお客様や関係者の方に出席いただきました。FMTの川田社長は、「創業以来、大過なくこの日を迎えられたのも、社員が真面目に仕事に取り組み、職場の和とクリーンな職場環境の維持に努めてきた結果であり、大いに誇りに思う」と語りました。



02 インターオプテックと資本・業務提携

今年1月、当社は次世代超高輝度LED向けサファイア基板の加工において優れた技術を保有する株式会社インターオプテック(松山寛文社長、東京都千代田区)の発行株式の約84%を取得し、資本・業務提携を行いました。次世代超高輝度LEDは、成長著しい信号機用途に加えて、より明るく、省エネ期待も高い自動車用ヘッドライトや家庭用蛍光灯などが主たる用途となるため、サファイア基板の超平坦加工が強く求められています。この資本・業務提携によって当社ビジネスの拡がりに加え、SiCほか硬脆材料基板の超平坦化技術開発の早期化も期待されます。

LED: Light Emitting Diodeの略。発光ダイオードのこと。青色の開発によって、光の三原色がそろい、さまざまな色の再現が可能となった。
SiC: 炭化けい素。約400℃以上の高温環境下でも動作する半導体素子が作れることから、冷却装置の簡素化とともに、エネルギー利用効率を高めることができる。

03 組織を変更しました

管理部門の一層の強化をめざし、今年4月1日付をもって組織変更を実施しました。主な変更点は次のとおりです。新規事業の調査研究及び新規事業機会の探索に機動性を持たせるため、経営企画室より「戦略事業課」を分離独立し、社長直轄の「戦略事業室」を新設しました。また、内部統制システムを構築し、内部管理体制の一層の充実を図るため、管理本部に「法務部」を新設し、その下に「知的財産課」「内部統制課(新設)」を置きました。さらに、技術本部に「研究管理部」を新設し、また、生産本部 各務原工場製造三課を二分し、製造四課を新設しました。

04 新工場の建設へ

各務東町工場に隣接する所有地に新工場(仮称:各務東町第三工場)を建設し、平成19年2月の竣工を目指します。これは半導体用シリコンウェハーの市場拡大と、それに伴うポリシング材の需要増、銅(Cu)向けを中心としたCMP用スラリーの需要増に対応するものです。今回の新工場建設によりこれら製品の生産能力を、平成17年度月産1,500トンから、平成20年度は月産2,500トンへ増強する計画です。



株式情報 (平成18年3月31日現在)

株式の状況

株式数	発行可能株式総数	120,000,000株
	発行済株式総数	30,699,500株
	株主数	5,594名

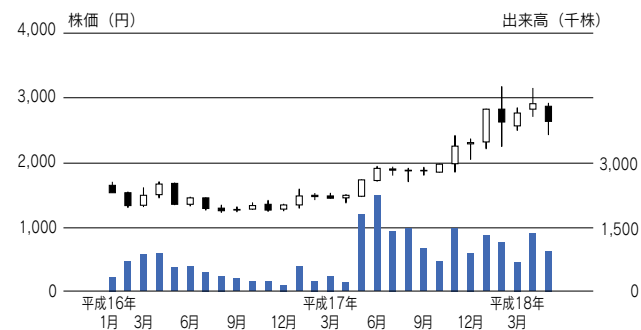
大株主

株主名	持株数	持株比率
越山 勇	3,302,310株	10.8%
野田 純孝	2,520,000	8.2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,703,100	5.5
有限会社コマ	1,638,360	5.3
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505019	1,262,600	4.1
株式会社フジインコーポレーテッド	1,243,497	4.1
越山 彰	1,141,400	3.7
株式会社三菱東京UFJ銀行	971,490	3.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	949,800	3.1
日本生命保険相互会社	779,880	2.5

役員 (平成18年3月31日現在)

代表取締役社長	越山 彰
常務取締役	永利 正
取締役	久保 昌昭
取締役	児玉 一志
取締役	中川 博行
取締役	松島 伸男
取締役	関 敬史
常勤監査役	藤本 俊之
常勤監査役	野田 純孝
監査役	鮎澤 多俊
監査役	山下 紀雄

株価および出来高の推移



* 株価データは、株式分割を過年度に遡及して調整した修正株価を使用しています。
 * 平成17年3月31日の最終株主名簿および実質株主名簿に記載された株主様に対し、1株に対し2株の割合をもって分割を行いました。

株主分布状況 (平成18年3月31日現在)

